



Nueva plataforma para realizar la "Fábrica Autónoma"

NPM-GH

Solución de automatización / ahorro de mano de obra + Solución de sistema inteligente para lograr una fabricación más acorde con el plan de producción

Key Features

El dispositivo de vanguardia de primera clase de la industria

Última evolución de la serie NPM G

Opción de operación remota

Opción de recuperación automática

Control autónomo de variaciones en 5Ms



NPM-GH

<https://latam.connect.panasonic.com/bo/es/productos/smart-factory-solutions/npm-gh>

PCB dimensions (mm)	Single-lane mode: L 50 mm × W50 mm ~ L 510 mm × W590 mmDual-lane mode: L 50 mm × W50 mm ~ L 510 mm × W 300 mm
PCB exchange	2.3 s (L 350 mm or less)5.0 s (L 350 mm or over to L 510 mm or less)
Electric Source	3-phase AC 200 , 220 , 380 , 400 , 420 , 480 V 2.1 kVA
Pneumatic Source	Min.0.5 MPa ~ Max. 0.8 MPa, 200 L / min (A.N.R.)
Dimension	W 975 mm × D 2 473 mm × H 1 444 mm
Mass	2 330 kg
Placement Head	FC16 headFC08 headFC03 head
Taping	FC16 head: Tape : 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 44 / 56 mmFC08 head: Tape : 4 ~ 56 / 72 mmFC03 head: Tape : 4 ~ 56 / 72 / 88 / 104 mm
Stick	FC08 head & FC03 head: ITF cart(17-slot) specifications : Max.48
Tray	FC08 head & FC03 head: Max.24
Placement Head max Speed	FC16 head: 51 500 cph (0.069 s / chip) high prod. / 37 500 cph (0.096 s / chip) high acc.FC08 head: 25 500 cph (0.141 s / chip) high prod. / 20 500 cph (0.176 s / chip): high acc.FC03 head: 10 100 cph (0.356 s / chip) high prod / 9 000 cph (0.4 s / chip) high acc.
Component dimensions	FC16 head: 0201 chip / 03015 chip ~ L 10 × W 10 × T 3FC08 head: 0402 chip ~ L 45 × W 45 or L 100 × W 40 × T 12FC03 head: 0603 chip ~ L 120 × W 90 or L 150 × W 25 × T 30
Placement Accuracy	FC16 head: ±25 µm /chip high prod / ±15 µm /chip high acc.FC08 head: ±25 µm / chip high prod / ±15 µm /chip high accFC03 head: ±25 µm / chip high prod / ±15 µm / chip high acc